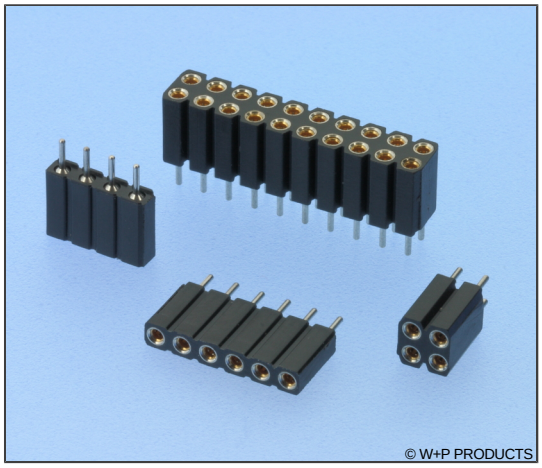
153

Präzisions-Buchsenleisten, RM 2,54mm, gerade, 1-/2-reihig, BH 7mm

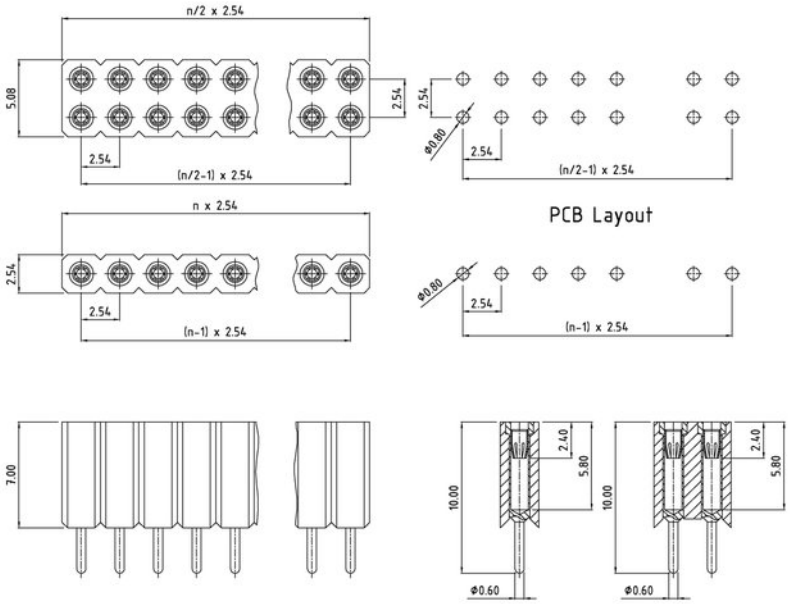
Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double Row, 7.0mm Profile

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
	Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass*
	Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC max.
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC max.*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*



Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins. Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Series	***Contacts****	***Rows****	***Sleeve Plating***	***Clip Plating****
153	**002**	**1**	**50**	**00**
	002-050 Einreihig *Single row* **004-100** Zweireihig *Double row*	**1** Einreihig *Single row* **2** Zweireihig *Double row*	**50** Hülse verzinnt *Tin plated sleeve*	**00** Feder vergoldet *Gold plated clip* **10** Feder 0,25µm Gold (Option) *0.25µm gold plated clip (Option)* **30** Feder 0,75µm Gold *0.75µm gold plated clip* **50** Feder verzinnt *Tin plated clip*

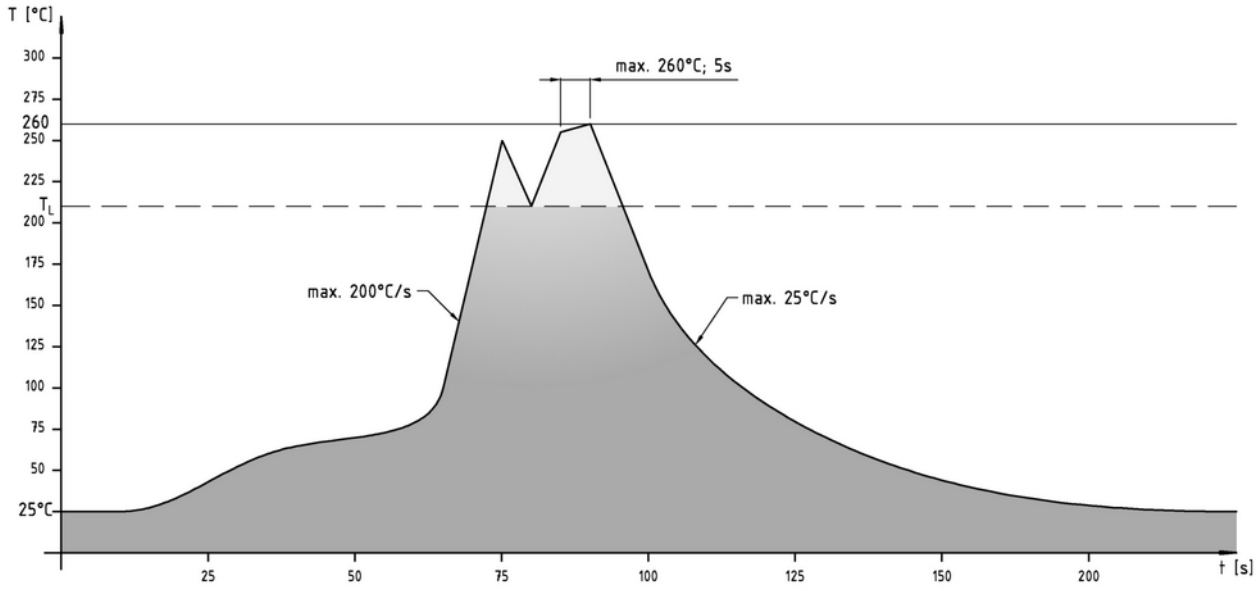
Auch dreireihig lieferbar!
Triple row also available!

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren
Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung
Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	**Key Values**
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*

